

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 12 月 22 日 (22.12.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/122247 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 23/00, 23/12, 23/28, H05K 3/46

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/008140

(22) 国際出願日: 2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2004-172141 2004 年 6 月 10 日 (10.06.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 恒岡 道朗 (TSU-NEOKA, Michiaki). 菅谷 康博 (SUGAYA, Yasuhiro). 勝又 雅昭 (KATSUMATA, Masaaki). 藤原 城二 (FUJIWARA, Joji).

(74) 代理人: 岩橋 文雄, 外 (IWAHASHI, Fumio et al.); 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

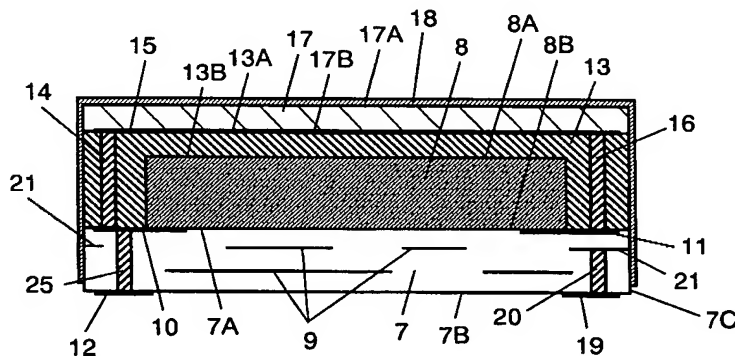
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COMPOSITE ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 複合型電子部品



(57) Abstract: A composite electronic component comprising a multilayer wiring board, a first power supply terminal electrode, a second power supply terminal electrode, a power supply electrode for external connection, a mounting component, an insulator, and a power supply pattern. The first power supply terminal electrode and the second power supply terminal electrode are provided on the first side of the multilayer wiring board, and the power supply electrode for external connection is provided on the second side of the multilayer wiring board opposite to the first side thereof and connected

with the first power supply terminal electrode. The mounting component is mounted on the first side of the multilayer wiring board and connected with the first and second power supply terminal electrodes on the first side. The insulator covers at least the second side of the mounting component opposite to the first side thereof, and the first and second power supply terminal electrodes with the first side thereof. The power supply pattern is provided on the second side of the insulator opposite to the first side thereof and connected with the first and second power supply terminal electrodes.

[続葉有]

WO 2005/122247 A1



---

(57) 要約:

複合型電子部品は、多層配線基板と第1電源端子電極と第2電源端子電極と外部接続用電源電極と実装部品と絶縁体と電源パターンとを有する。第1電源端子電極と第2電源端子電極は、多層配線基板の第1面に設けられ、外部接続用電源電極は、多層配線基板の第1面に対向する第2面に設けられるとともに第1電源端子電極に接続されている。実装部品は、多層配線基板の第1面に実装されるとともに第1電源端子電極と第2電源端子電極とに、その第1面にて接続されている。絶縁体は、少なくとも実装部品の第1面に対向する第2面と第1電源端子電極と第2電源端子電極とを、その第1面にて覆っている。電源パターンは、絶縁体の第1面に対向する第2面に設けられ、第1電源端子電極と第2電源端子電極とに接続されている。